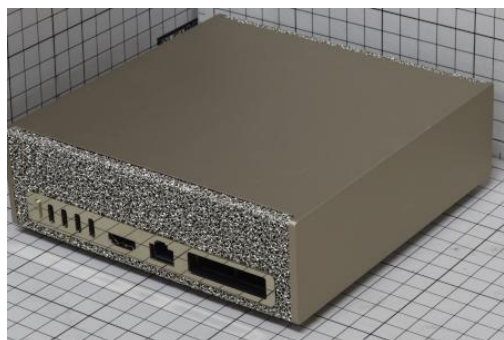
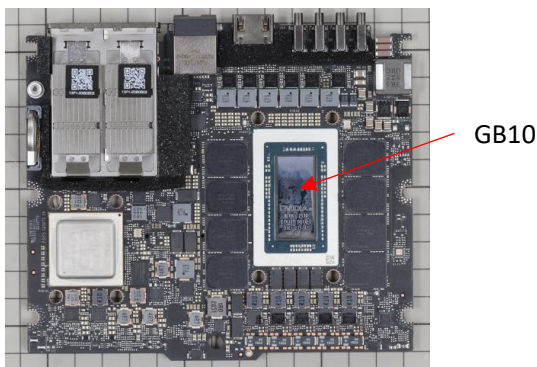


AI Computer : Nvidia GB10 Grace Blackwell_NVIDIA DGX Spark搭載 パッケージ&基板詳細解析レポート



NVIDIA DGX Spark™製品外観



製品基板

製品概要

NVIDIA DGX Spark™は、GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載した世界最小クラスのAIスーパーコンピューターで、卓上サイズながら最大1ペタフロップの性能を発揮し、2000億パラメータ規模の生成AIモデルをローカルで扱える高効率システムです。GB10 Grace Blackwell Superchipは、NVIDIAが2025年に発表した最新AI向けSoCで、CPUとGPUを統合したペタフロップ級の処理性能を持つ革新的チップです。GB10はGrace CPUとBlackwell GPUを2.5D技術で統合し、128GB統合メモリ搭載の高効率小型パッケージです。

今回、以下5つのレポートをリリース予定です。

1. 製品分解、基板搭載半導体部品調査 : 25R-0698-1
2. 基板各層（14層）最細部のL/W測定 : 25R-0698-2
3. パッケージ各層(12層)画像データ : 25R-0698-3
4. 基板、パッケージの断面解析 : 25R-0698-4
5. チップ解析（Top層、ゲート層、SEM断面 (Seal Ring)）: 25R-0698-5

詳細は次ページへ

1. 製品分解、基板搭載半導体部品調査 : 25G-0698-1

価格 : 680,000円 リリース予定 : 1/30

- 製品分解過程
- 搭載半導体調査
- データシート (見つかった場合)
- ソケットなどの搭載部品拡大写真

2-1. 基板各層 (14層) 最細部のL/W測定 : 25G-0698-2

価格 : 650,000円 リリース予定 : 3/31

- 各層(14層)の最細部の線幅、線ピッチ測定

2-2. Option : CADデータ 25G-0698-6

価格 : 6,000,000円 リリース予定 : 3/31

- Power,GNDラインの特定
- ODB++、Gerberなど

3-1. パッケージ各層(12層)画像データ : 25G-0698-3

価格 : 500,000円 リリース予定 : 2/27

- 各配線情報 (各層(12層)の写真、線幅、線ピッチ)

3-2.Option : CADデータ 25G-0698-7

価格 : 2,500,000円) リリース予定 : 3/31

- Power,GNDラインの特定
- ODB++、Gerberなど

4. 基板、パッケージ断面解析 : 25G-0698-4

価格 : 250,000円 リリース予定 : 1/30

- パッケージX線写真
- 断面構造
- 各層厚さ測定

5-1 チップ構造解析 : 25G-0698-5

価格 : 400,000円 リリース予定 : 2026/3/31

- Seal Ring部SEM 断面
- Top層、ゲート層写真

5-2 Option: フロアプラン解析 25G-0698-8

価格 : 350,000円 リリース予定 : 2026/4/15

日程、価格は暫定ですので予告なく変更する場合があります。